



Flussmittel OSPI 3311

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Technische Daten OSPI 3311

Ver: 3.0 22-10-13

No-clean Flussmittel für OSP

Beschreibung:

Interflux® **OSPI 3311** ist ein no-clean Flussmittel das speziell entwickelt worden ist für das Lötten von Leiterplatten mit OSP-Beschichtung die ein oder mehrere Reflowprozesse bestanden haben.

Die meiste OSP-Beschichtungen degradieren schnell nach dem Reflowprozess. Sicherlich mit bleifreien Legierungen macht das die Benetzung und Durchstieg beim Wellen- und Selektivlötten eine richtige Herausforderung.

Die Bestandteile von **OSPI 3311** sind sorgfältig gewählt worden um den Durchstieg und die Benetzung von diesen degradierten OSP-Beschichtungen zu begünstigen, auch bei hohen Fördergeschwindigkeiten.

Auch ist das Flussmittel absolut halogenfrei und entworfen um sicher und zuverlässig zu sein.

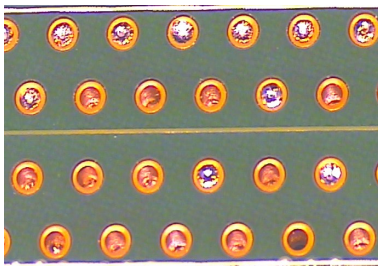
OSPI 3311 besteht die IPC-Anforderungen.



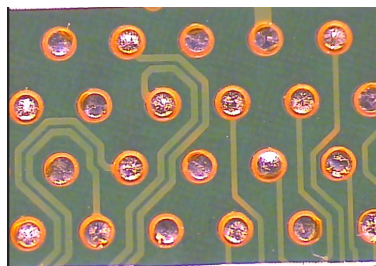
Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen	durchsichtige, farblose Flüssigkeit
Feststoffgehalt	7 % +/- 1%
Spezifische Dichte (20°C)	0.823 g/ml ±0.005
Säurezahl	50 - 70 mg KOH/g
Geruch	Alkohol
IPC/EN	OR/L0

Durchstieg



Standard Flussmittel



OSPI 3311

OSP-LP, gelötet mit 1,6m/min mit einer SnCu Lötwellen nach 2x Reflow und 24Std.



RoHS
compliant
2002/95/EC

Seite 1

Mehr Info:

Durchstieg	1
Auftrag	2
Vorheizung und Wellenkontakt	
Testergebnisse	2
Verpackung	3

Eigenschaften:

- Sehr gute Benetzung von degradiertem OSP
- Hohe Fördergeschwindigkeiten möglich
- Absolut halogenfrei
- Für SnPb und bleifreie Legierungen



Auftrag

Flussmittel kann auf verschiedene Weisen aufgetragen werden: Sprühen, Schäumen, Tauchen...

Beim Sprühen ist es wichtig eine gleichmäßige Verteilung über die Lötseite der LP zu bekommen. Sprühen von beiden Seiten ist empfehlenswert und die Geschwindigkeit des Sprühkopfes soll an die Fördergeschwindigkeit angepasst werden. Jeder

Punkt zweimal sprühen ist empfehlenswert. Ein Karton, Glasplatte oder alte LP kann benützt werden um diese gleichmäßige Verteilung zu überprüfen. Ein gutes Penetrieren vom Flussmittel in die Löcher ist auch sehr wichtig. Das Flussmittel soll bis an der Oberseite gelangen. Der richtige Sprühdruk und Flussmittelmenge sind wichtig. Das kann mittels eines Faxpapiers

an der Oberseite der unbestückten LP überprüft werden.

Um Rückstände zu ermäßigen ist es wichtig die minimale Auftragsmenge zu finden. Sie wird gefunden durch die Menge mit guten Ergebnissen zu reduzieren bis Probleme auftauchen wie schlechter Durchstieg, Brücken,...und sie dann wieder zu erhöhen.

Vorheizung und Wellenkontakt

Eine Vorheizung wird benützt um den T°-Shock der LP beim Wellenkontakt zu ermäßigen und das Lösemittel des Flussmittels zu verdampfen. Die Vorheizung kann den Durchstieg auf LPn mit hoher thermischen Masse (Cu, Bauteile,...) beeinflussen. Mehr Vorheizung kann den Durchstieg auf diesen LPn begünstigen. Das Fluss-

mittel hat keine Untergrenze in der Vorheizung aber es ist empfehlenswert die Zeit über 180°C zu ermäßigen um Erschöpfung des Flussmittels zu vermeiden. Der Wellenkontakt wird von der Eintauchtiefe, dem Lötwinkel und der Geschwindigkeit bestimmt. Mehr Kontakt kann den Durchstieg begünstigen. Man soll aber beachten die

LP oder die Bauteile nicht zu überhitzen oder die LP nicht zu überschwemmen (Eintauchtiefe zu Groß). Generell ist das Wellenkontakt 1-2 Sek. für die Vorlötwellen und 2-4 Sek. für die Hauptwelle.

Testergebnisse

nach EN 61190-1-2(2002) und IPC J-STD-004A

Eigenschaft	Ergebnis	Methode
Chemisch		
Aktivierung	OR LO	J-STD-004A
Kupferspiegeltest	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Qualitative Halogene		
Silberchromat (Cl, Br)	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33D
Fluorid-Tüpfeltest (F)	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35.1A
Quantitative Halogene	0,00%	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.35C
Klimatest		
SIR-Test	bestanden	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3B



Verpackung:

HDPE-Behälter von:
10L, 25L und 200L

Handelsname : OSPI 3311 No-Clean Soldering Flux for OSP

Haftungsausschluss

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich nach bestem Wissen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Möglichkeiten, unter denen die oben genannten Produkte eingesetzt werden können, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie über die Verwendbarkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte für den jeweiligen Anwendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzuführen. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Die letzte Version dieses Dokumentes finden Sie auf:

www.interflux.com/de

Das Dokument in einer anderen Sprache?:

www.interflux.com